(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月14日(14.08.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/169732 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *H01L 21/3065* (2006.01)
C23C 16/458 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/001959

(22) 国際出願日： 2025年1月22日(22.01.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-015694 2024年2月5日(05.02.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

(72) 発明者: 川 端 淳 史 (**KAWABATA Atsushi**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

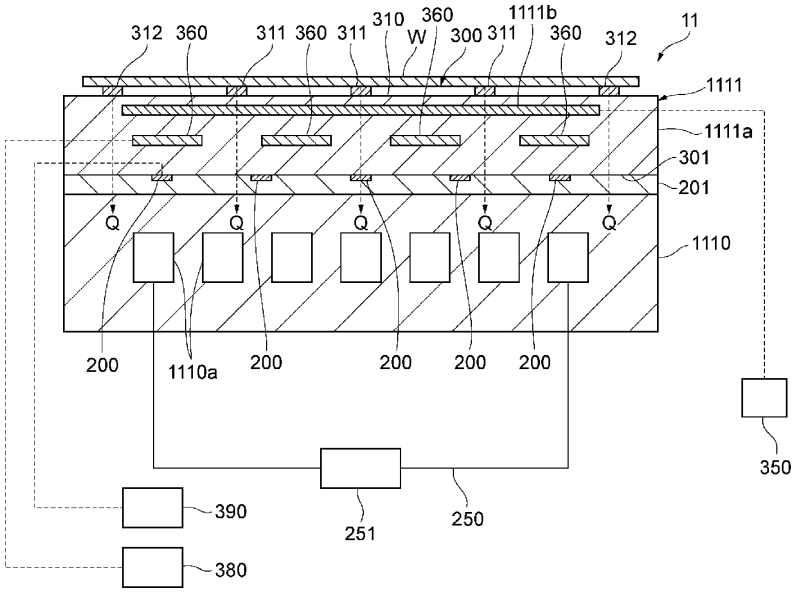
(74) 代理人: 佐 藤 睦，外 (**SATO Atsushi** et al.); 〒1066123 東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

WO 2025/169732 A1

(54) **Title:** SUBSTRATE SUPPORT, ELECTROSTATIC CHUCK, PLASMA PROCESSING APPARATUS, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTROSTATIC CHUCK

(54) 発明の名称： 基板支持体、静電チャック、プラズマ処理装置及び静電チャックの製造方法



(57) **Abstract:** The purpose of the present invention is to provide a technique capable of quickly controlling a temperature of a substrate and a substrate support. This substrate support is provided with: a base having a flow path through which a temperature control medium flows; a support part disposed on the base, the support part having a front surface that supports the substrate and a rear surface; and a heat flux sensor disposed on the rear surface of the support part.

［続葉有］

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約:基板や基板支持体を迅速に温度制御することができる技術を提供する。基板支持体は、温調媒体が流れる流路を有する基台と、基台上に配置される支持部であって、支持部は、基板を支持する表面と、裏面とを有する、支持部と、支持部の裏面に配置される熱流束センサと、を備える。